证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2024-014

上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

公司 2023 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,747,177,186 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 109,887,087.44 元（含税）。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用额度不超过 200,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。

监事会认为：本次公司增加部分募投项目实施主体不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，决策和审批程序符合相关规定。同意增加控股子公司上海新傲芯翼科技有限公司为募投项目“300mm 高端硅基材料研发中试项目”的实施主体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

10、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

表决情况：全体监事对本事项回避表决，直接提请股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2024-008

上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基础，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 186,542,762.23 元，母公司期末可供分配利润为 113,941,633.21 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,747,177,186 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 109,887,087.44 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 59%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为，该利润分配方案考虑了公司的经营状况和未来资金需求，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

公司代码：688126　　公司简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,747,177,186 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 109,887,087.44 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 59%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李祎	王艳
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
电话	021-52589038	021-52589038
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。公司作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最高的半导体硅片企业之一，将扩大生产规模、丰富产品结构、提高市场占有率作为公司业务发展的重要战略任务。

公司目前产品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片及外延片、SOI 硅片、压电薄膜衬底材料等，产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

公司现拥有众多国内外知名客户，包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微等国内所有主要芯片制造企业，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

截止本报告期末，子公司上海新昇正在实施的新增 30 万片 / 月 300mm 半导体硅片产能建设项目实现新增产能 15 万片 / 月，公司 300mm 半导体硅片合计产能已达到 45 万片 / 月，预计 2024 年产能达到 60 万片 / 月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片 / 月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超过 6.5 万片 / 月。

（二）主要经营模式

1.盈利模式

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片实现收入和利润。

2.采购模式

为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。达到经营资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期及付款周期等众多标准要求的供应商，才可以被考虑纳入公司合格供应商名录，并定期审核。目前，公司已经与全球众多供应商建立了长期、稳定的合作关系。

3.生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式，大部分产品按订单批量生产，同时进行少量备货式生产。在生产方面，公司建立了生产管理制度，对生产过程中的各个因素进行控制，合理安排生产，协调各项生产活动，确保产品质量及交付满足规定的要求和客户的需求。在自主生产为主的同时，公司结合市场情况和自身产能利用情况，在部分非关键性技术生产环节适当配以外协加工进行辅助，以最大化满足市场需求。

4.销售模式

报告期内，公司全部产品均通过直销模式销售。由于半导体硅片的行业壁垒较高，生产企业和主要下游客户较为集中，公司通常采取主动开发潜在客户并与客户直接谈判的方式获取订单。同时，公司也通过少量代理商协助开展中小客户的接洽工作。

5.研发模式

公司是“产、学、研一体化”研发模式的践行者，未来将继续实行这一研发模式，继续与教学科研机构紧密合作，在公司改进自身技术的同时，促进中国半导体硅片行业的科学技术进步，提升中国半导体硅片的科研水平。公司将进一步加大核心产品相关技术的研发投入，在最前沿的单晶生长、切割、研磨、抛光、外延与 SOI 技术方面继续追赶国际先进水平。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

长期以来，半导体行业呈现周期性波动上涨的趋势。根据 SEMI 统计，2016 年至 2023 年间，全球半导体硅片（不含 SOI）销售额从 72.09 亿美元上升至 121.29 亿美元，年均复合增长率达 7.72%。2016 年至 2023 年间，中国大陆半导体硅片销售额从 5 亿美元上升至 17.32 亿美元，年均复合增长率高达 19.43%，高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率。2016 年至 2023 年间，全球 SOI 硅片市场销售额从 4.41 亿美元增长至 16.94 亿美元，年均复合增长率 21.20%。。

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布的数据，2023 年全球半导体市场规模为 5,269 亿美元，同比下降 8.22%。SEMI 数据显示，2023 年全球半导体硅片（不含 SOI）出货面积合计 12,602 百万平方英寸，同比下降 14.35%。未来在全球宏观经济环境相对疲软的情况下，受新能源汽车、5G 移动通信、人工智能、大数据等终端市场的驱动，半导体行业仍然将保持较高的市场需求。

结合 Gartner、Techinsights 等机构的中长期预测，预计受新能源汽车、大数据以及人工智能等产业的快速发展驱动，半导体产业将在 2024 年恢复增长、进入周期性上升通道。公司所处半导体硅片细分行业处于半导体产业链上游，经营业绩与整体半导体行业所呈现的景气度密切相关。

（2）行业发展的基本特点

半导体行业整体上呈周期性波动和螺旋式上升的趋势，半导体硅片行业的市场波动基本同步于整个半导体行业的波动周期。全球半导体产业已经进入“后摩尔定律时代”，市场需求长期来看仍将不断增长，因此扩充产能并同时进行技术升级是各个产业链环节上的企业应对市场挑战、抓住市场时机、探索发展机会的基础。

据 SEMI 统计，从 2023 年至 2025 年，全球半导体行业预计将有 82 个新的晶圆厂投入运营，其中包括 2024 年的 44 个项目和 2025 年的 25 个项目。尽管目前国际主要半导体硅片企业均已启动扩产计划，但其预计产能长期来看仍无法完全满足全球范围内芯片制造企业对半导体硅片的增量需求，叠加中长期供应安全保障考虑，国内半导体硅片行业仍将处于快速发展阶段。

（3）主要技术门槛

半导体硅片作为芯片制造的关键原材料，技术门槛较高，属于技术密集、人才密集行业。产业链下游的半导体芯片制造通常采用不同工艺制程完成，不同的芯片制程工艺技术节点，对应于不同的特征尺寸和最小线宽，对半导体硅片晶体原生缺陷和杂质控制水平、硅片表面和边缘平整度、翘曲度、厚度均匀性等提出了不同的技术指标要求。下游芯片制程的技术节点越先进，特征尺寸越小，对应的硅片上述指标控制越严格，不同的技术节点对应的指标控制参数甚至会相差几个数量级。

公司掌握了半导体硅片生产的多项核心技术，包括但不限于 300mm、200mm、以及小尺寸半导体硅片相关的直拉单晶生长、磁场直拉单晶生长、热场模拟和设计、大直径硅锭线切割、高精度滚圆、高效低应力线切割、化学腐蚀、双面研磨、边缘研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光、硅片清洗、外延等技术以及 SOI 制备技术，全面突破了 300mm 近完美单晶生长、超平坦抛光工艺以及极限表征等关键技术瓶颈，并建立了具有国际化水平的 300mm 硅材料极限表征体系，强有力支撑了研发工作的快速迭代，保障了公司半导体硅片产品质量与国际领先水平的同步提升。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体硅片行业是寡头垄断的行业，长期以来均被全球前五大硅片厂商垄断，包括日本的信越化学和 SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国 Siltronic 和韩国 SK Siltron，上述五家企业合计占据近 90%市场份额。

公司以全球前五大为目标，业务发展迅速，作为国内领先的半导体硅片企业之一，始终将扩大生产规模、丰富产品结构、持续提高市场占有率作为公司业务的重要战略任务。报告期内，公司各子公司分别启动了符合公司发展目标的扩产建设项目，以实现 300mm 及 200mm 半导体硅片产能的扩充和 300mm 高端硅基材料国内技术空白的填补，在保持国内领先地位的基础上，把握当前市场机遇，快速提升国际综合竞争力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路制程亦称为工艺节点或特征线宽，即晶体管栅极宽度的尺寸，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准。随着半导体制程的不断缩小，芯片制造工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度不断降低。对应在半导体硅片的制造过程中，需要更加严格地控制硅片表面微粗糙度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标，这些参数将直接影响半导体产品的成品率和性能。

一般来讲，300mm 芯片制造对应的是 90nm 及以下的工艺制程，包括常见的 90nm、65nm、55nm、45nm、28nm、16/14nm、10/7nm、5/3nm 等；200mm 芯片制造对应的是 90nm 以上的工艺制程，包括常见的 0.13μm、0.15μm、0.18μm、0.25μm 等。

依照摩尔定律，集成电路朝着面积更小、速度更快、价格更便宜、能耗更低的方向前进。与此同时，大量应用如射频器件、传感器、功率器件等，考虑到实际技术需求和成本、可靠性等，可以在 28nm 及以上技术节点的成熟工艺生产线上制造，无需遵循摩尔定律。因此 28nm 以上的成熟技术节点硅片，仍存在大量需求。

总的来说，未来随着 5G/6G、人工智能、云计算、物联网、智能汽车等多种技术的发展和应用的拓展，半导体（硅片）一方面仍然会沿着摩尔定律向更先进的 5nm、3nm、2nm 制程前进，另一方面 28nm 以上的成熟制程仍将在很长一段时间内继续发展。两者共同促进智能社会、智慧生活的到来。

除此之外，受新能源汽车市场驱动，面向汽车电子应用的各类车规级芯片需求日益增长，随着相关芯片制造工艺的技术升级，对相应的半导体硅片产品提出了新的要求，各类用于车规级驱动芯片、电源管理芯片、IGBT、功率器件、图像传感器、MCU 等的特殊规格 300mm 硅片产品、200mm 硅片产品以及 SOI 产品都将迎来新的市场机会，同时也对半导体硅片企业的技术研发能力、产品组合积累以及一站式服务能力提出了更高要求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,903,175.583574	2,546,260.641408	14.02	1,625,671.27
归属于上市公司股东的净资产	1,511,434.054744	1,429,099.671548	5.76	1,042,193.24
营业收入	319,030.129534	360,036.096274	−11.39	246,683.22
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	310,823.887414	351,509.926419	−11.57	240,635.16
归属于上市公司股东的净利润	18,654.276223	32,503.17042	−42.61	14,611.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−16,594.39	11,524.88	−243.99	−13,163.78
经营活动产生的现金流量净额	−27,472.735818	45,881.557771	−159.88	30,748.96
加权平均净资产收益率(%)	1.27	2.29	减少 1.02 个百分点	1.47
基本每股收益(元 / 股)	0.068	0.121	−43.8	0.059
稀释每股收益(元 / 股)	0.068	0.119	−42.86	0.058
研发投入占营业收入的比例(%)	6.96	5.97	增加 1.09 个百分点	5.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	80,298.21	77,083.65	81,634.74	80,013.53
归属于上市公司股东的净利润	10,478.54	8,260.02	2,515.74	−2,600.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	731.24	−3,189.91	−3,836.86	−10,298.86
经营活动产生的现金流量净额	35,446.97	−39,136.78	−13,859.42	−9,923.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,072
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,544
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	567,000,000	20.64	0	0	无	0	国有法人
上海国盛（集团）有限公司	−21,000,000	546,000,000	19.87	0	0	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	−23,651,150	134,722,145	4.90	0	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司−华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	66,346,309	126,435,178	4.60	0	0	无	0	其他
上海新阳半导体材料股份有限公司	15,072,900	123,199,310	4.48	0	0	质押	27,310,000	境内非国有法人
上海新傲科技集团有限公司	−19,430,284	117,152,572	4.26	0	0	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	−54,840,594	82,959,406	3.02	0	0	无	0	其他
华芯投资管理有限责任公司−国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	72,011,521	2.62	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司−诺安成长混合型证券投资基金	−3,164,520	56,133,748	2.04	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司−易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	27,521,125	46,329,060	1.69	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			/					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			/					

存托凭证持有人情况

□适用　　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

√适用　　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海硅产业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23 沪硅 K1	240187	2028−11−17	13.4	3.17
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 沪硅产业 MTN001	102102271	2024−11−10	5	3.58

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	2023 年度付息 1790 万元

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　　□不适用

单位：10000　币种：CNY

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	29.37	23.24	26.38
扣除非经常性损益后净利润	−16,594.39	11,524.88	−243.99
EBITDA 全部债务比	0.19	0.39	−51.28
利息保障倍数	2.99	5.66	−47.17

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为 319,030.13 万元，较上年同期减少 11.39%，主要系 2023 年度受整体经济环境和半导体市场下行周期的影响所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2024-009

上海硅产业集团股份有限公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货、预付款项和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为其中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测算，公司 2023 年计提的各项减值损失总额约为 9,977.08 万元左右。具体情况如下表所示：

单位：人民币　万元

资产名称	账面余额	资产可收回金额	资产可收回金额的计算过程	本次计提资产减值准备的依据	本期计提金额	计提原因
存货	155,255.34	144,901.79	按存货成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备	按照企业会计准则的规定，期末按照存货的可变现净值计算应计提的存货跌价准备	9,002.15	单独测算
应收账款	58,541.97	56,836.01	将应收款项分为：单项计提预期信用损失和按组合计提预期信用损失，并根据整个存续期间内预期信用损失的情况计提减值损失。	按照企业会计准则的规定更新计算截至期末的预期信用损失。	1,103.60	根据企业准则进行预期信用损失的测算
其他应收款	5,760.35	5,237.91	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失	按照企业会计准则的规定更新计算截至期末的预期信用损失。	−128.67	根据企业准则进行预期信用损失的测算
预付款项	16,405.44	16,268.72	预付款项的可收回金额为公司预计能流入公司的经济利益，即预计能收到的货物，对于存在很可能无法收到货物风险的预付款项，公司对应计提资产减值损失。			
合计	235,963.09	223,244.43			9,977.08	

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对 2023 年 12 月 31 日的存货项目进行减值测试并计提存货跌价准备损失约 9,002.15 万元，其中主要为针对存货成本高于估计售价的硅片产品。2023 年由于扩产过程中存货库存大幅增加，导致存货跌价准备的金额较上年同期有所增长。

2. 坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计。经测试，2023 年公司需计提的应收款项信用减值损失和其他应收款信用减值损失约 974.93 万元。

3. 预付款项

公司对于出现减值迹象的预付账款，主要为存在很可能无法收到货物风险的预付款项，公司按照其可回收金额计提减值准备。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2024-011

上海硅产业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 200,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金存放情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2021］3930 号），公司于 2022 年 2 月向特定对象发行股票 240,038,399 股，每股发行价 20.83 元人民币，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元，扣除发行费用人民币 53,814,364.71 元后，募集资金净额为人民币 4,946,185,486.46 元。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字(2022)第 0162 号验资报告予以确认。

公司已对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专户余额为人民币 73,730.95 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目	金额(万元)
再融资募集资金专户年初金额	157,339.63
加：年初用于现金管理金额	165,000.00
再融资募集资金年初金额	322,339.63
减：本年度直接投入募投项目	133,717.90
用于现金管理金额	120,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	5,109.22
再融资募集资金专户期末余额	73,730.95

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年 11 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司＜募集资金使用管理制度＞的议案》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的向特定对象发行 A 股股票募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额（万元）
平安银行上海南京西路支行	上海硅产业集团股份有限公司	15981666888880	活期	605.75
上海银行嘉定支行	上海硅产业集团股份有限公司	03004841882	活期	6,239.66
中国银行上海市张江高科技园区支行	上海硅产业集团股份有限公司	457282551286	活期	106.87
招商银行上海华灵支行	上海新昇半导体科技有限公司	121921770510806	活期	448.34
招商银行上海华灵支行	上海新昇晶投半导体科技有限公司	121945833410718	活期	0.01
招商银行上海华灵支行	上海新昇晶科半导体科技有限公司	121945865110918	活期	35,124.21
上海银行嘉定支行	上海新傲科技股份有限公司	03004911414	活期	31,206.11
总计				73,730.95

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，于 2022 年 2 月，公司及保荐机构分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 5 月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 6 月，公司及保荐机构与上海新傲科技股份有限公司并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 7 月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司、上海晶昇新诚半导体科技有限公司（后更名为“上海新昇晶投半导体科技有限公司”，以下简称“新昇晶投”）、上海新昇晶科半导体科技有限公司并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”

三、2023 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件 1：2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至 2022 年 5 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,941.99 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至 2022 年 5 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第 4117 号）。

2022 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 6 月 24 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据《上海证券交